

TEST & PACKAGE CENTER

TP Center Invitation Day



Date

AUG. 23 TUE

10:00
17:00



Venue

Test&Package Center
Samsung Electronics



Presentation

About TP Center

About Package

About TEST

About Semiconductor equipment

Please Look Page 'P'

TP Center Invitation Day



Test & Package Center



삼성전자 DS부문 Test&Package Center는 세계 최대 규모의 Packaging Site로, 반제품의 Wafer를 완제품의 반도체 및 Module(SSD)로 제품화하는 후공정을 담당하고 있습니다.



Test&Package Center는 업계 최고의 경쟁력을 보유하고 있으며 제품의 경박단소화에 따른 반도체 미세화 등 차세대 반도체 경쟁력을 위해 **공정, 설비, 재료, 자동화, S/W기술**의 융합으로 Package 기술의 선진화를 이룩하고 있습니다.

TP Center Invitation Day



Participation Way (RSVP)



신청자 중 최종 초청 대상자를 선정하며, 초청 대상자에 한하여 참석이 가능합니다. 참가를 원하시는 분은, 첨부 양식을 작성하여 신청해 주세요.



참가 신청 : 첨부 파일 작성하여, 8.12(金)까지 career.tp@samsung.com로 회신



문의 : +82-41-540-8154

TP Center Invitation Day



Contents

